

露笑科技股份有限公司 关于合资公司碳化硅项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月8日、2020年9月15日分别与合肥市长丰县人民政府、安徽长丰双凤经济开发区管理委员会签署《合肥市长丰县与露笑科技股份有限公司共同投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园的战略合作框架协议》和《长丰县招商引资项目投资合作协议》，详见2020年8月10日和2020年9月16日披露的相关公告。

公司于2020年10月16日与合肥北城资本管理有限公司（以下简称“合肥北城”）、长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）（以下简称“长丰四面体”）签署了《合资协议》，协议约定三方合作在安徽省合肥市长丰县投资建设“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”（下称“项目”），并共同出资设立一家有限责任公司作为本项目的项目公司。合资公司名称为“合肥露笑半导体材料有限公司”（以下简称“合肥露笑半导体”），注册资本2亿元人民币，该部分资金将主要用于碳化硅厂房的初步建设，公司占47.5%，合肥北城占47.5%，长丰四面体占5%，合资公司为公司的参股公司，详见2020年10月19日披露的相关公告。

现将项目进展情况公告如下：

公司于2021年6月25日与合肥北城、长丰四面体、合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投促基金”）、合肥露笑半导体签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定对合肥露笑半导体增加1.1亿元注册资本，投促基金拟认缴目标公司新增注册资本9,500万元，露笑科技拟认缴目标公司新增注册资本1,500万元，详见2021年6月26日披露的相关公告。

截至本公告日，合肥露笑半导体研发的碳化硅衬底片已送样检测通过，目前

正在积极向下游客户进行送样；合肥露笑半导体一期生产用设备的安装调试工作已经完成，并准备近期投产。

本次碳化硅衬底片送检通过展示出合肥露笑半导体在碳化硅领域强大的产品研发技术能力，有利于其开拓市场，推动产品销售，对未来经营业绩产生积极影响。目前碳化硅项目整体进展符合公司预期，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日